

2023

Investor Meeting

法人說明會

總經理 黃道景

2023.06.28

發言人：盧修滿協理 / claire@niching.com.tw

代理發言人：邱智芳協理 / chris@niching.com.tw

股務聯絡人：陳玲芝課長 / cherry@niching.com.tw



投資安全聲明

本內容可能包含「前瞻性陳述」，包括(但不限於)未來展望、預測及估算等預期性之陳述。這些前瞻性陳述乃基於本公司經營的信念及對於未來的目前看法。這些看法可能受到內外風險及不確定性因素影響，有造成實際結果與陳述內容顯著不符之可能。

本文件所做出的任何前瞻性陳述僅於陳述日當日適用，投資者應有自主判斷，不應過分依賴該等前瞻性陳述。對於這些看法，除法規規定外，未來若有任何變更或調整時，本公司並不負責隨時提醒或更新。本節所述的警告聲明適用於本簡報所載的所有前瞻性陳述。



營運報告

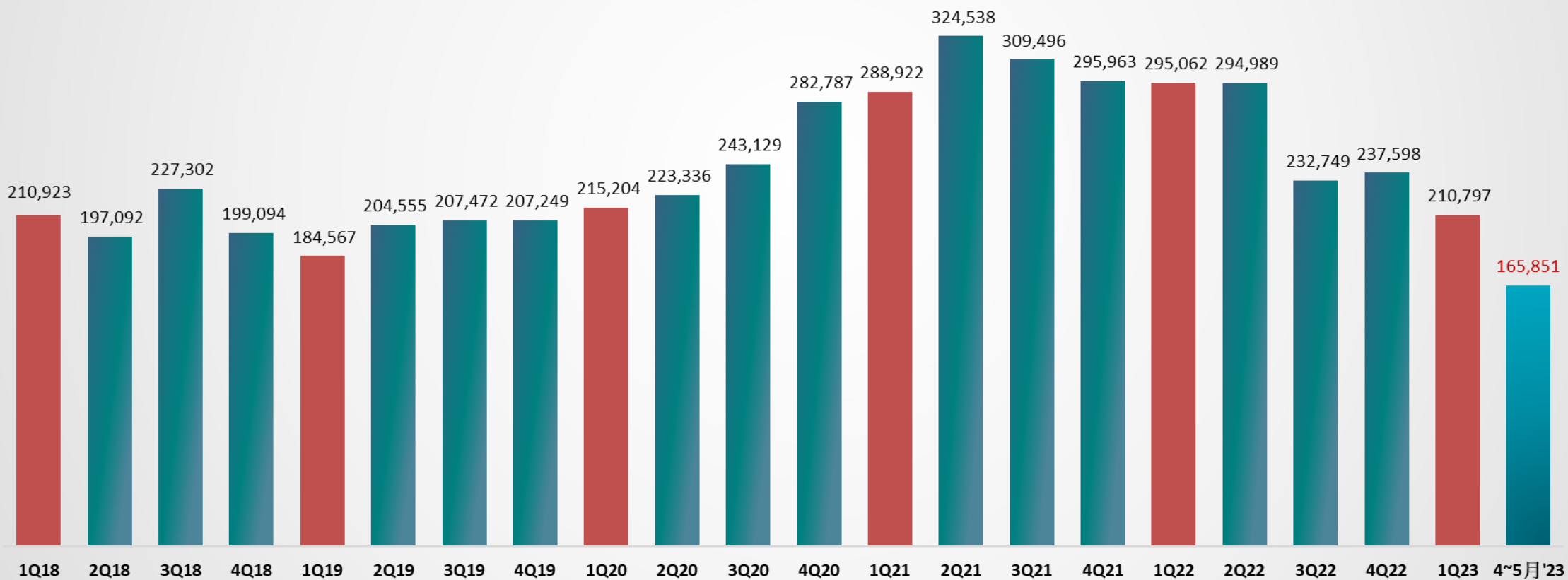
2023Q1 & 4~5月



季別營收

單位：仟元

年度	2018	2019	2020	2021	2022	2023Q1	2023/4~5月
營業收入	834,411	803,842	964,457	1,218,919	1,060,398	210,797	165,851

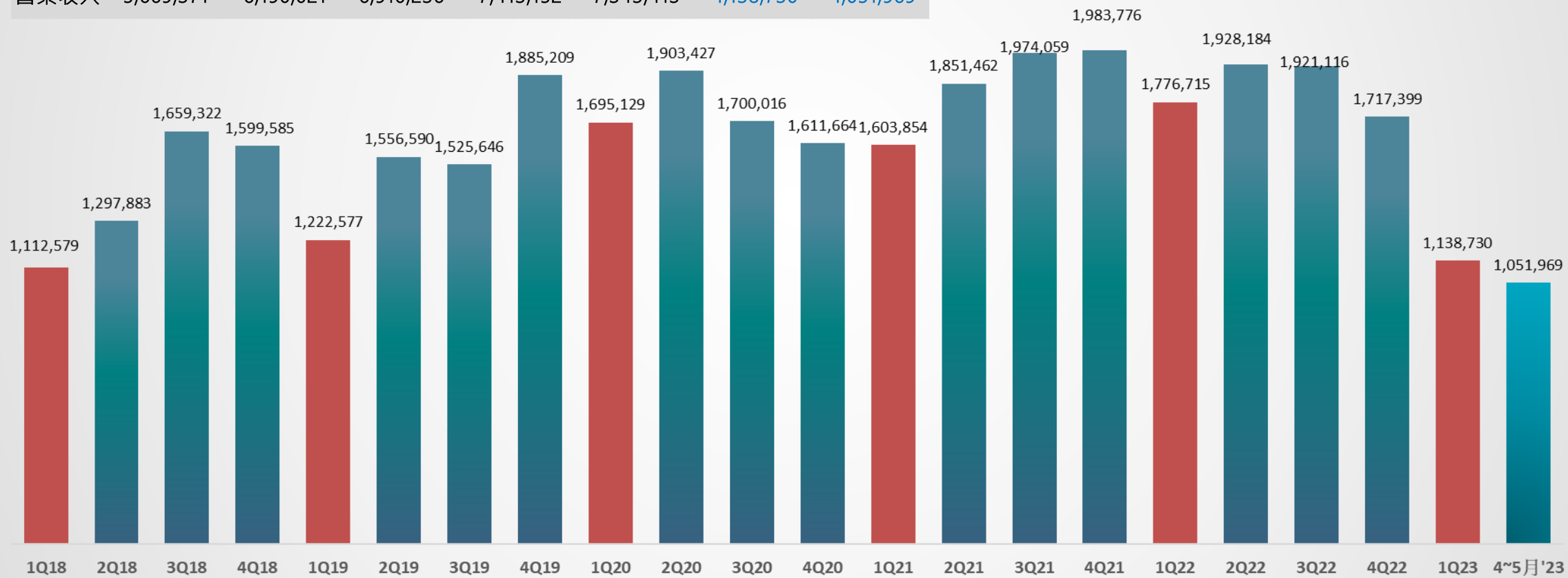




季別整體交易金額

單位：仟元

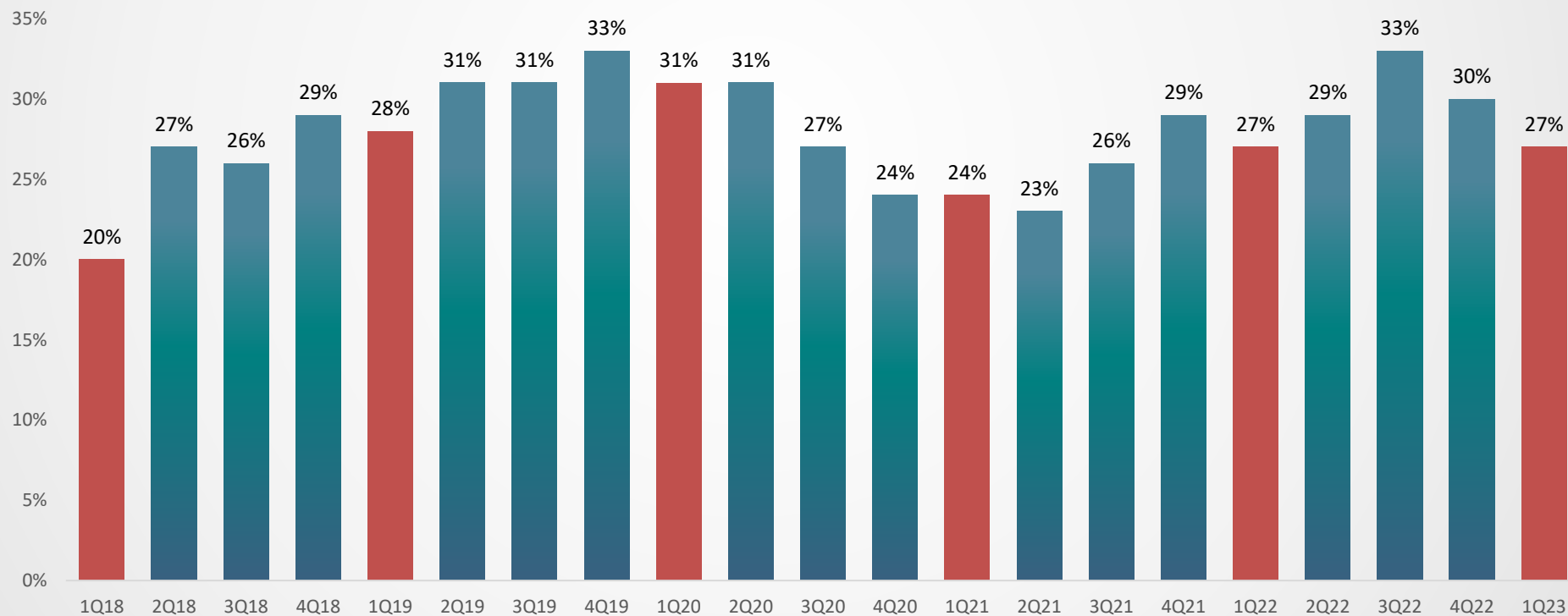
年度	2018	2019	2020	2021	2022	2023Q1	2023/4~5月
營業收入	5,669,371	6,190,021	6,910,236	7,413,152	7,343,413	1,138,730	1,051,969





歷年季毛利率

年度	2018	2019	2020	2021	2022	1Q 2023
毛利率	25%	31%	28%	25%	29%	27%

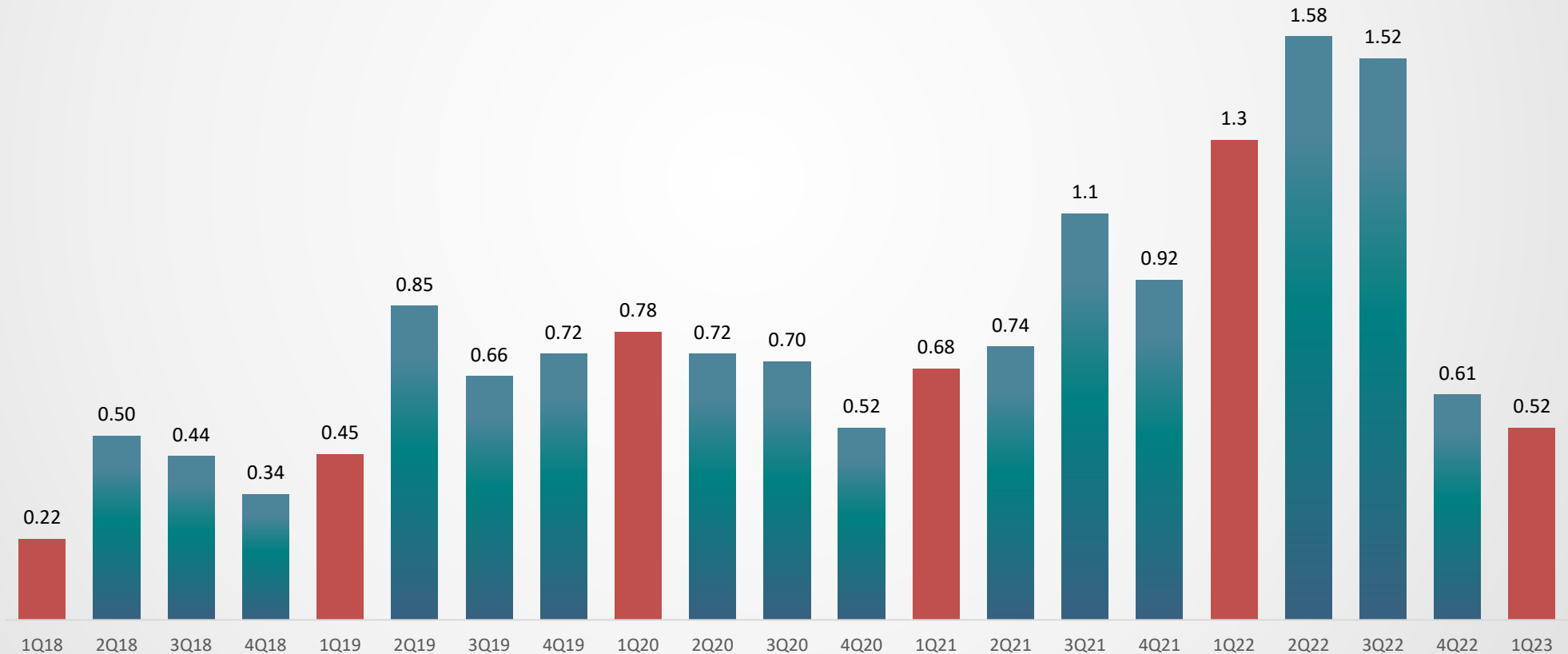




歷年季每股稅後盈餘

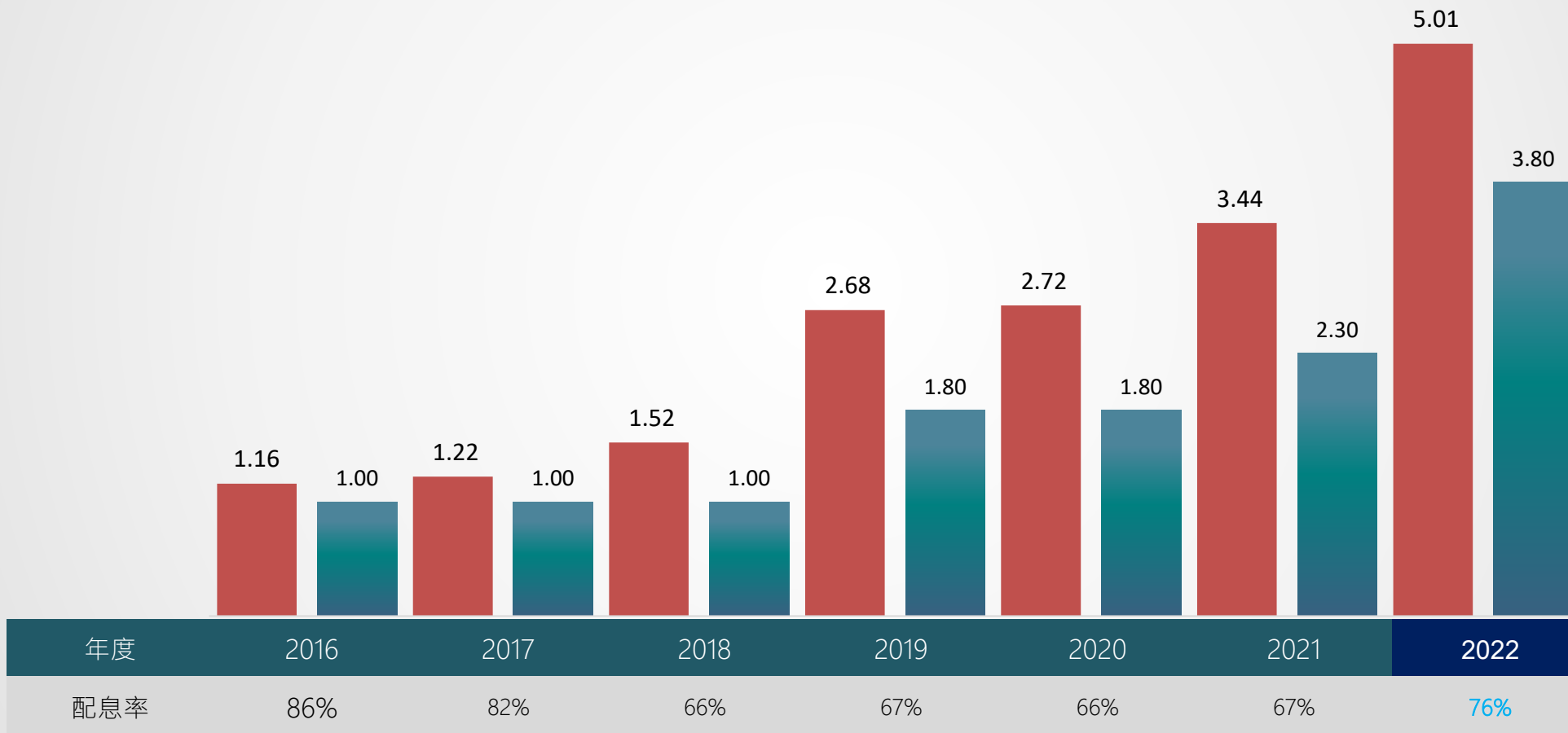
年度	2018	2019	2020	2021	2022	2023Q1
EPS	1.52	2.68	2.72	3.44	5.01	0.52

單位：元





歷年配息率





綜合損益表

(NT\$仟元)	2018	2019	2020	2021	2022	1Q 2023
營業收入	834,412	803,840	964,457	1,218,919	1,060,398	210,797
營業毛利	211,740	247,412	269,474	310,457	310,949	56,697
毛利率	25%	31%	28%	26%	29%	27%
營業淨利	54,804	90,716	118,685	150,568	124,057	8,440
營業外收(支)	26,278	36,979	6,510	15,294	110,067	13,599
稅前淨利	81,082	127,695	125,195	165,862	234,124	22,039
本期淨利	59,507	104,772	106,431	134,428	195,976	21,252
淨利率	7%	13%	11%	11%	18%	10%
EPS (NT\$)	1.52	2.68	2.72	3.44	5.01	0.52



資產負債表

NT\$仟元	2018	2019	2020	2021	2022	1Q 2023
資產						
現金及約當現金	137,517	181,508	170,088	279,765	327,431	461,943
應收帳款	326,653	308,359	597,702	509,553	532,247	439,385
存貨	52,375	42,020	47,736	66,764	60,048	70,970
轉投資相關	115,827	179,631	188,357	205,830	257,247	267,666
不動產、廠房及設備	230,989	228,328	227,025	228,528	226,154	225,625
其他資產	48,740	198,747	71,074	23,817	26,539	26,915
資產總計	912,101	1,138,593	1,301,982	1,314,257	1,429,666	1,492,504
負債						
短期借款	15,000	173,000	224,782	126,429	150,000	-
應付帳款	158,465	159,823	240,718	265,051	227,968	195,004
其他負債	88,201	110,332	99,569	115,613	131,435	271,318
負債總計	261,666	443,155	565,069	507,093	509,403	466,322
權益總計	650,435	695,438	736,913	807,164	920,263	1,026,182
淨值 (NT\$元)	16.63	17.78	18.84	20.64	23.53	23.26



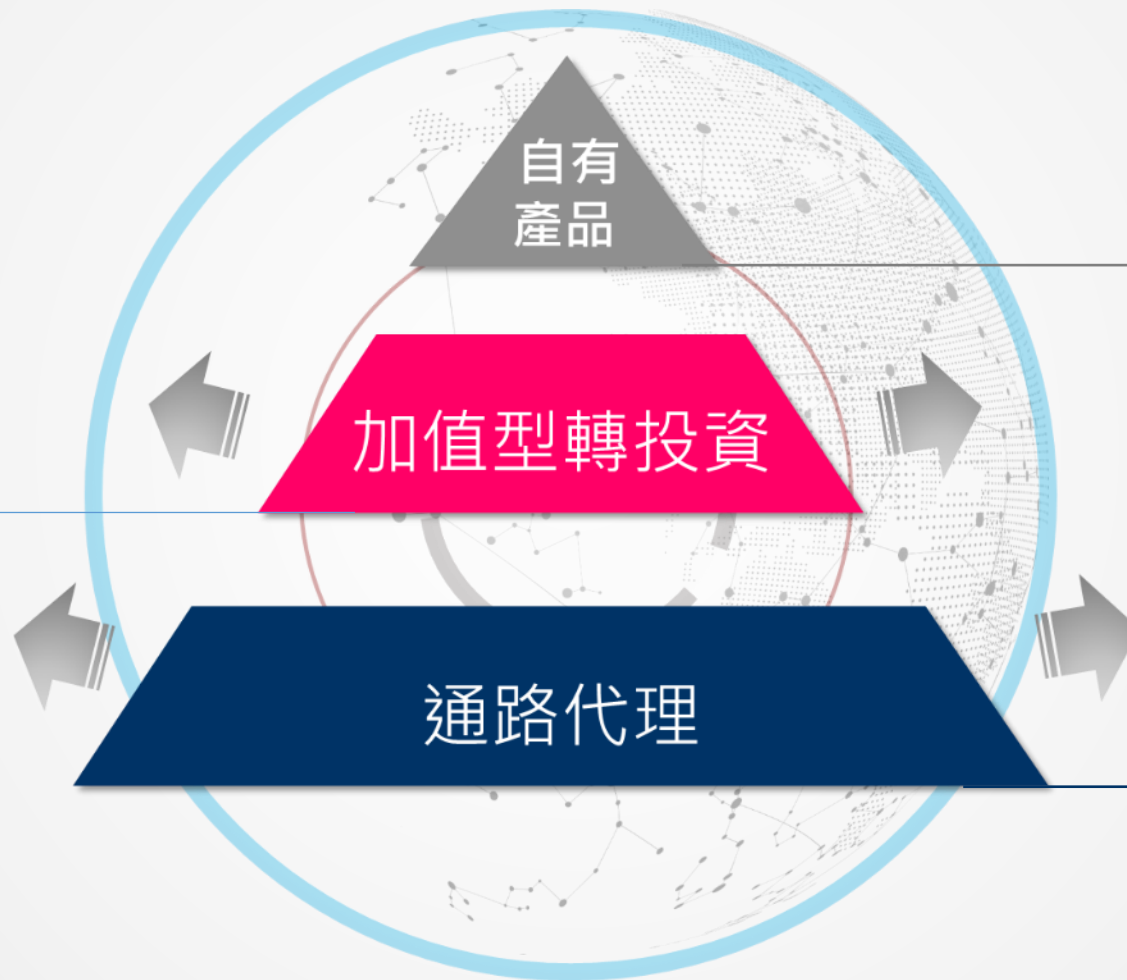
營 運 展 望

2023 Q2 & Q3



營運三佈局

獲利擴張
企業價值提升



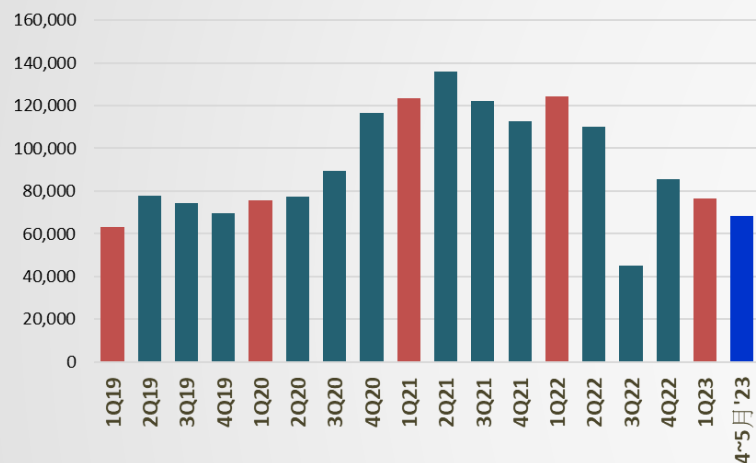
獲利新機
發展未來機會

獲利根基
鞏固核心業務



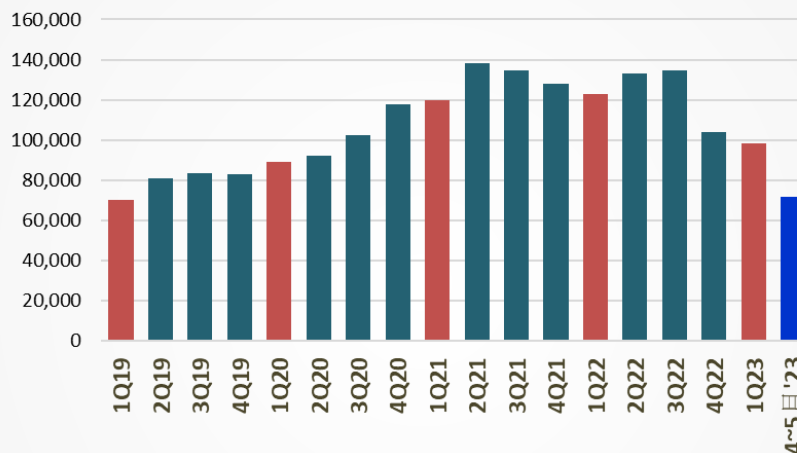
營運佈局一：通路代理

驅動IC相關



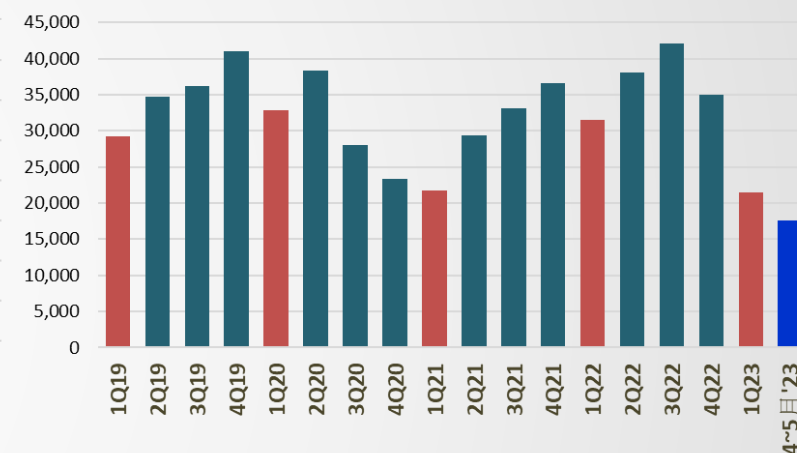
1. Q2營收成長可期，將逐季復甦
2. 工控、車用仍為成長關鍵

封測相關



1. 封測相關Q2營收將與Q1相仿
2. 客戶庫存緩減中
3. 5G wifi & 車用佔比提高，全年仍可望成長
4. 高散熱需求強勁，帶動均熱片需求向上

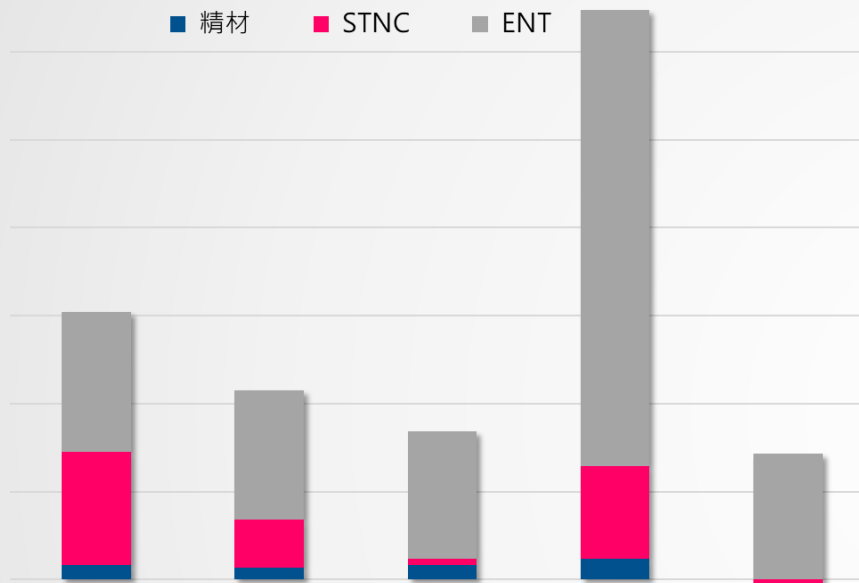
記憶體/邏輯IC載板



1. 庫存調整期間超過預期
2. 邏輯產品逐漸復甦但稍緩慢
3. 佈局System IC領域帶動成長
4. Q2優於Q1



營運佈局二： 加值型轉投資



(NT\$仟元)	2019	2020	2021	2022	2023Q1
精材	1,680	1,344	1,680	2,351	
STNC	12,799	5,493	669	10,537	(1,457)
ENT	15,904	14,669	14,485	51,899	14,266
TOT	30,382	21,506	16,834	64,787	12,809

ENT 利騰國際

- 中系與美系客戶需求逐季回穩，下半年有望優於上半年

STNC 信泰蘇州

- 同半導體載板，Q2優於Q1，明顯的復甦要到Q4




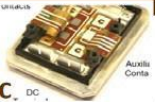
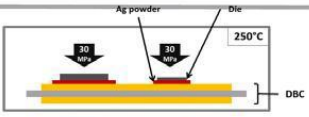


精材科技

- 與驅動IC市場景氣同步，Q2優於Q1，逐季回升

營運佈局三：自有產品

Technology trends for power semiconductor

- High temperature endurable materials >220oC (silver sintering, encapsulations)
- High reliable and low stress interconnections (foil interconnects, ultrasonic bonding)
- Thermal cooling solution (Dual-side cooling / micro-channel cooling)

	Current solutions <i>Widely used by all players</i>	Emerging technos <i>At mass production and growing in market shares</i>	Potential breakthrough <i>At R&D stage. Still too expensive</i>
Interconnection	 <p>Al wire bonding</p>	<p>Al ribbon bonding</p>  <p>Copper wire bonding</p> 	<p>Foil sintering</p> <p>Foil ultrasonic wedge bonding</p> 
Die attach	<p>Pb/Sn alloy Or SAC alloy</p>	 <p>Silver micro powder sintering</p>	<p>Nano powder sintering (no heating and pressure for attach process)</p>
Baseplate Cooling	<p>Baseplate + heatsink AlSiC for long lifetime Al2O3 for cost</p>	<p>Thermal exchange improvements:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Shower power • DBC to heatsink (no baseplate) 	 <p>Micro-channel cooling</p>

↑

DBC on both sides:
flip chip
+ Sintering on both sides
+Cooling on both sides

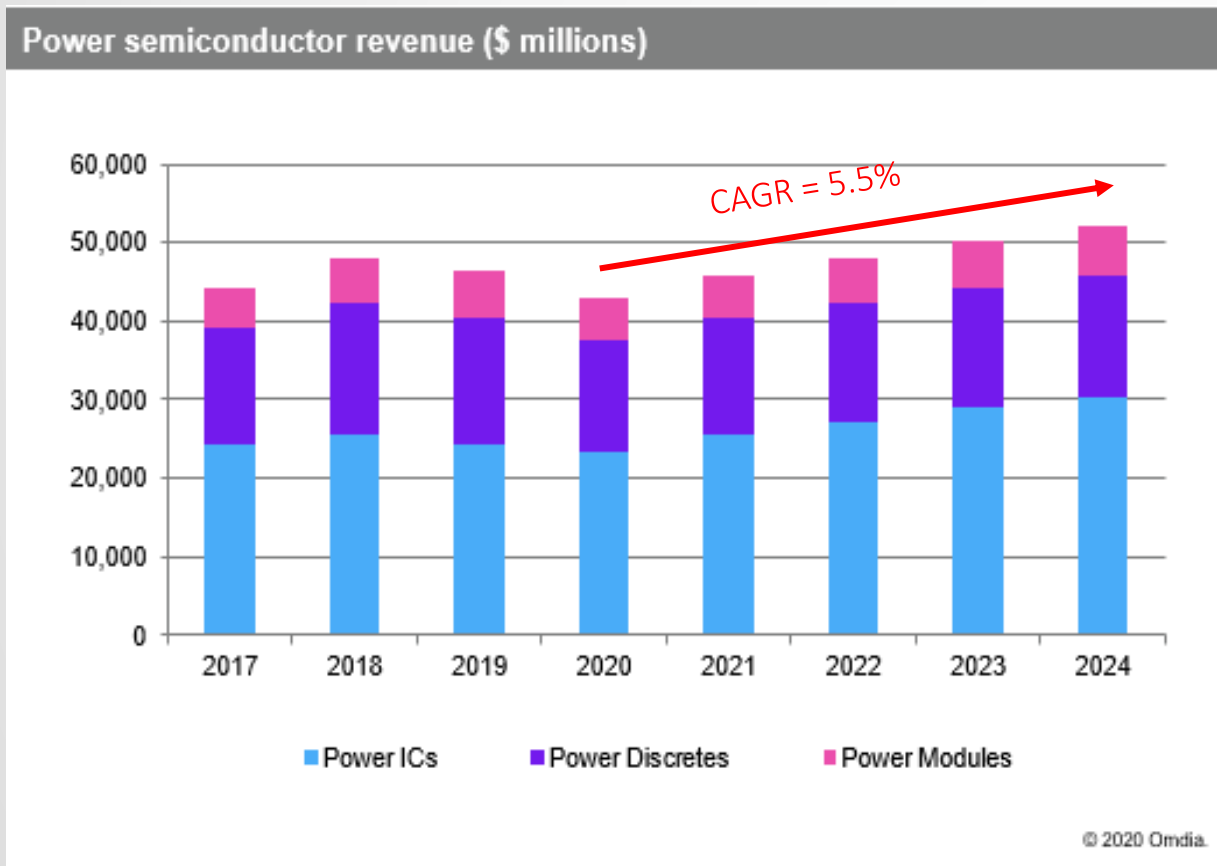
↓



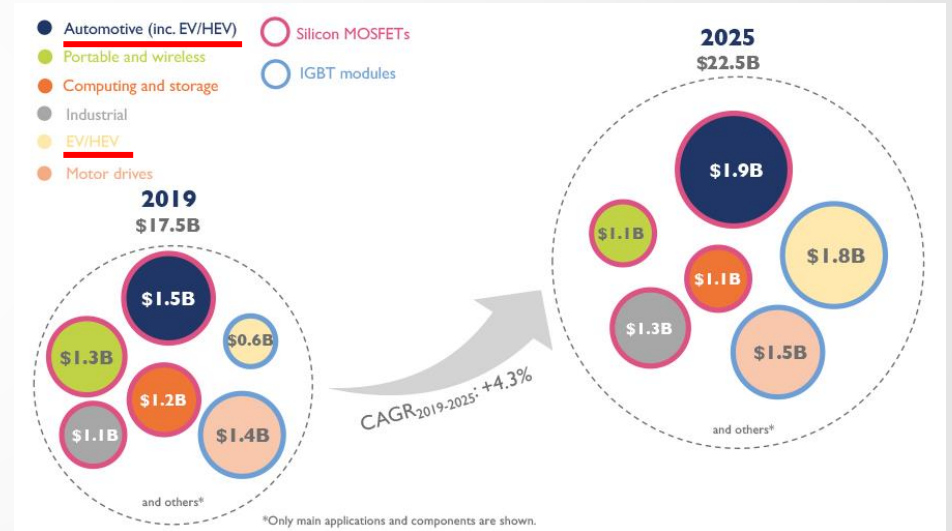
營運佈局三：自有產品

Power Semiconductor Market

Overview for Overall Market



Main Segment of Power Semicon.

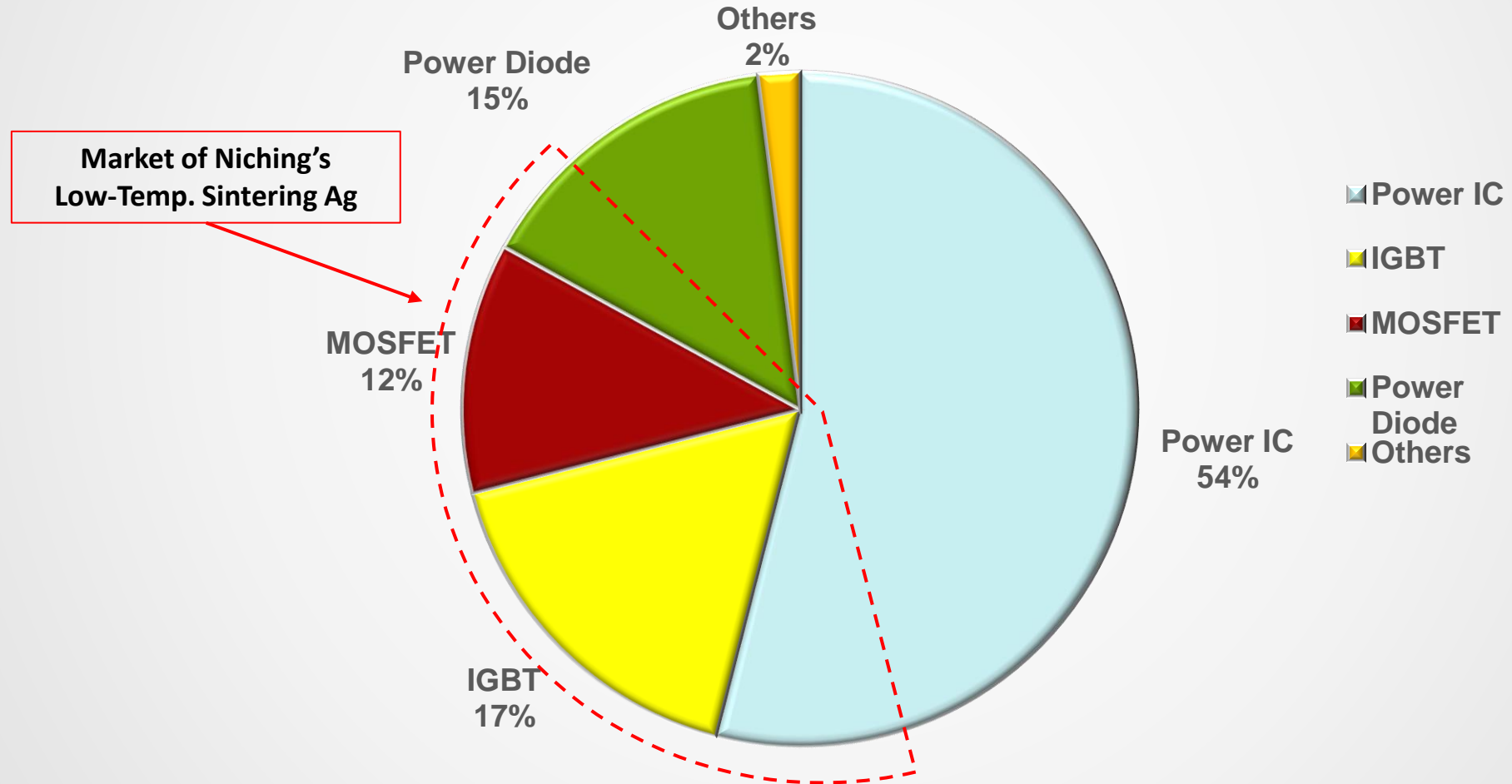


IGBTs and MOSFETs: the growing market driven by rising energy efficiency requirement in multiple applications, especially in EV/HEV.



營運佈局三：自有產品

Power Semiconductor Segment



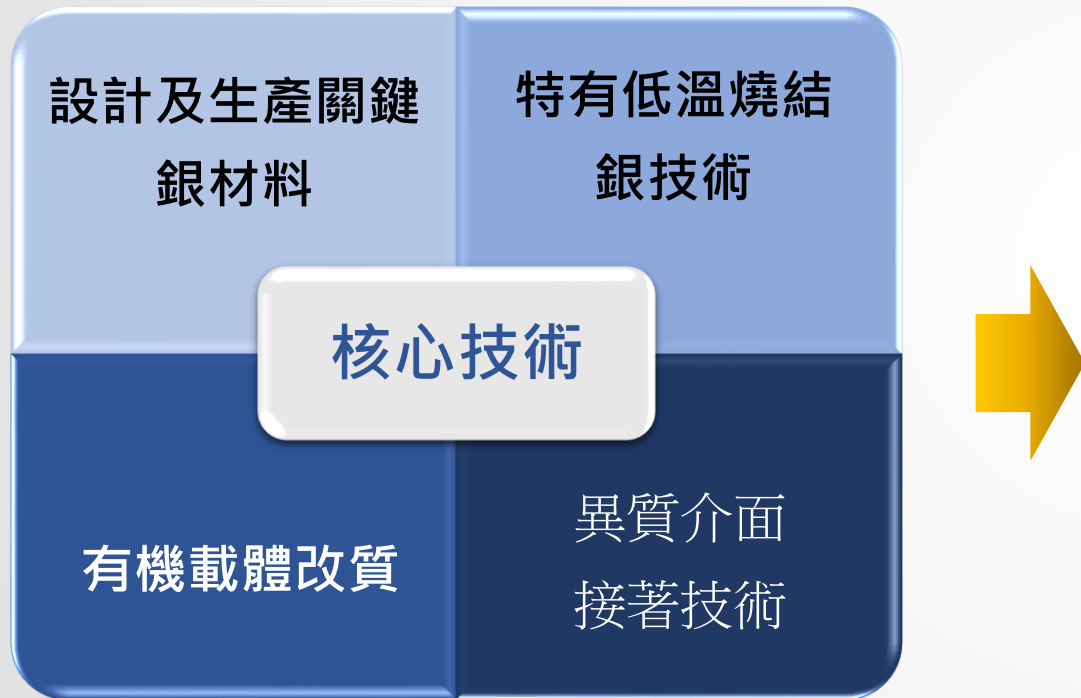
營運佈局三：自有產品 自有產品核心技術 & 能力





營運佈局三：自有產品 自有產品核心技術 & 能力

Product Feature





營運佈局三：自有產品 產品系列推展現狀

產品系列	EVT	DVT	PVT	MP
客製化銀漿			DX-23 (S,local) RFID	DX-30 (L,local) 車用電致變色材料
高導熱銀漿	DN-17(E,local) LED		DN-1715(E,local) LED車燈	DN-1715(E,local) LED車燈
低溫燒結銀漿		DN 1802(A, local) 封裝與測試	DN-1802(A, Netherlands) RF	
		DN-1206Q(J, China) 封裝與測試		
		DN-1301B(S, USA) RF/PA IC		
觸控銀漿		PS-07B(S, local) 手機與汽車按鍵與模組		PL 09F(H, local) 工控面板
				PL-10(M, local) 工控面板

EVT → DVT → PVT → MP

EVT : Engineering Verification Test (工程驗證測試階段)

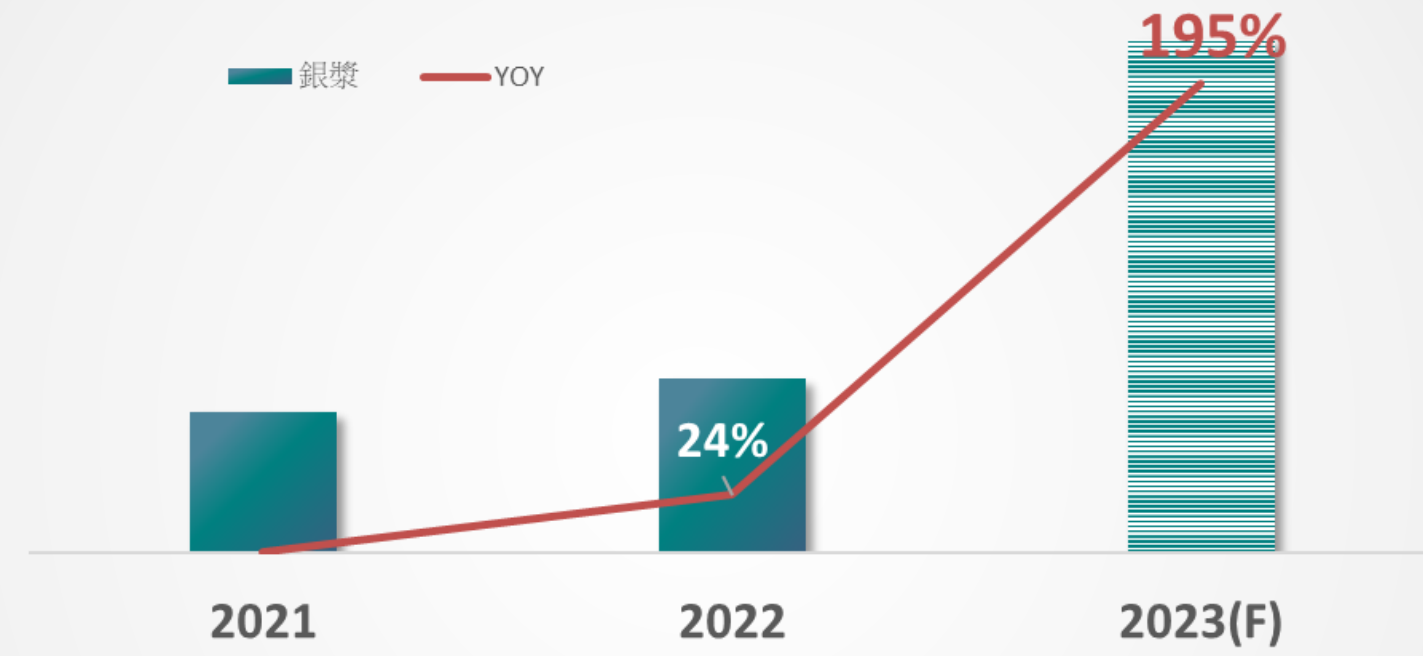
DVT: Design Verification Test (設計驗證測試階段)

PVT: Production Verification Test (生產驗證測試階段)

MP: Mass Production (導入量產階段)

營運佈局三：自有產品

近三年自有產品營收成長率





本季總結

- 一. 上半年雖然處景氣谷底，Q2將優於Q1；庫存水位持續降低，整體回暖時間預估落於Q4：
 1. 驅動IC相關：與預測相符，今年已明顯逐季回升
 2. 封測相關：上半年二季持平，下半年預估微幅成長。
 3. 半導體載板：持續以提高邏輯載板佔比調整產品策略。
- 二. 加值型轉投資：2023年維持高獲利之挹注，主要來自ENT仍將維持Socket高階市場的高市佔率。
- 三. 自有產品：銀漿6月已獲車用部份訂單，下半年持續耕耘RF ID及LED車用訂單。



近期重要事件摘要

- 一. 利機企業董事會通過處分轉投資韓商APET CO., LTD全數持股，總成交目標金額6.34億韓元(約當NTD1.46億元)，預計處分完成後保留盈餘將增加84,865仟元，不影響每股盈餘。APET公司股權出售案，買方仍在進行DD等程序，目前進展順利惟成交與否及最終價格仍有變數，提醒投資人注意。



THANKS